

はんだ付される電気及び電子組立品に関する 要件事項 - 「宇宙・軍事用途向け追加規格」

目次

本追加規格では、以下の項目について記述している：

- 0.1 適用範囲
 - 0.1.1 目的
 - 0.1.2 優先
 - 0.1.3 既存設計品または認可済み設計品
 - 0.1.4 使用
 - 0.1.5 鉛フリーすず
 - 0.1.6 赤疹腐食（酸化銅の腐食）
 - 0.1.7 材料および工程のトレーサビリティ

下記に示す参照番号はJ-STD-001Gの項番号であり、本追加規格において変更または追加を行った項である。

1.1	適用範囲
1.2	目的
1.7	優先順位
1.7.1	矛盾事項
1.10	人材の能力
1.11	許容要件
1.13.2.2	高周波の使用
1.13.2.3	高電圧の使用
3.1	材料
3.2	はんだ
3.2.1	はんだ - 鉛フリー
3.3	フラックス：
3.8.1	部品およびシール部の損傷
4.2.3	照明
4.5	部品表面処理の除去
4.5.1	金めっき除去
4.9	一般的な部品の実装要件
4.9.2	リードの変形限度
4.15.3	乾燥 / 脱気
4.18.1	露出面
4.18.2	はんだ接合の異常
4.18.3	部分的に目視可または隠れたはんだ接合部

5.1.2	より線の損傷
5.3.6	端子の取り付け - はんだ付
5.4.1.6	絶縁スリーブ（穴あき、フック型およびカップ型 端子にはんだ付されたワイヤー）
5.5	端子へのはんだ付
5.6.3	ワイヤーの固定
6.1	スルーホール 端子接続 - 一般概要
6.1.1	リードの成形
6.1.2	端子接続要件
6.2.2	スルーホール部品リードのはんだ付
6.3.1	アンサポーテッドホールのリード接合要件
7	部品の表面実装
7.1.2	表面実装デバイスのリード成形
7.1.3	リードの変形（意図的ではない曲げ）
7.5.6	壁面溝付き（キャスタレーション）電極
7.5.8	丸径または平坦化ガルウイングリード
7.5.14	表面実装エリアアレイパッケージ
7.5.15	下面電極部品 (BTC; Bottom Termination Components)
7.5.16	サーマルプレーン下面電極部品 (D-Pak)
7.5.17	平坦化ポスト接合
8.3	はんだ付後の洗浄
8.3.1	異物破片 (FOD)
8.3.2	フラックス残さおよびその他のイオン性または有 機汚染物質
9.1.1	気泡 / デラミネーション（層間剥離）
9.1.2	織糸露出 / カットファイバー
9.1.9	焼け
9.1.11	ミーズリング
10	コーティング、封止、固定（接着）
10.3	コンフォーマルコーティング - 適用
10.3.10	コンフォーマルコーティングのリワークまたは修正
10.6	固定（接着剤）
[新規]	
12.1.2	目視検査
12.3	統計的工程管理
13.2	リペア